

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2024 年 5 月 10 日 (10.05.2024)



(10) 国际公布号
WO 2024/093427 A1

- (51) 国际专利分类号:
F24C 7/02 (2006.01) *F24C 15/16* (2006.01)
F24C 7/06 (2006.01) *H05B 6/64* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2023/112627
- (22) 国际申请日: 2023 年 8 月 11 日 (11.08.2023)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
202211374046.0 2022 年 11 月 3 日 (03.11.2022) CN
202310168007.3 2023 年 2 月 23 日 (23.02.2023) CN
- (71) 申请人: 广东美的厨房电器制造有限公司 (GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东

省佛山市顺德区北滘镇永安路 6 号, Guangdong 528311 (CN)。

- (72) 发明人: 林刚 (LIN, Gang); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇永安路 6 号, Guangdong 528311 (CN)。刘涛 (LIU, Tao); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇永安路 6 号, Guangdong 528311 (CN)。侯国威 (HOU, Guowei); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇永安路 6 号, Guangdong 528311 (CN)。

- (74) 代理人: 北京辰权知识产权代理有限公司 (BEIJING CHENQUAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM); 中国北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2601 室, Beijing 100190 (CN)。

- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,

(54) Title: COOKING APPLIANCE

(54) 发明名称: 烹饪器具

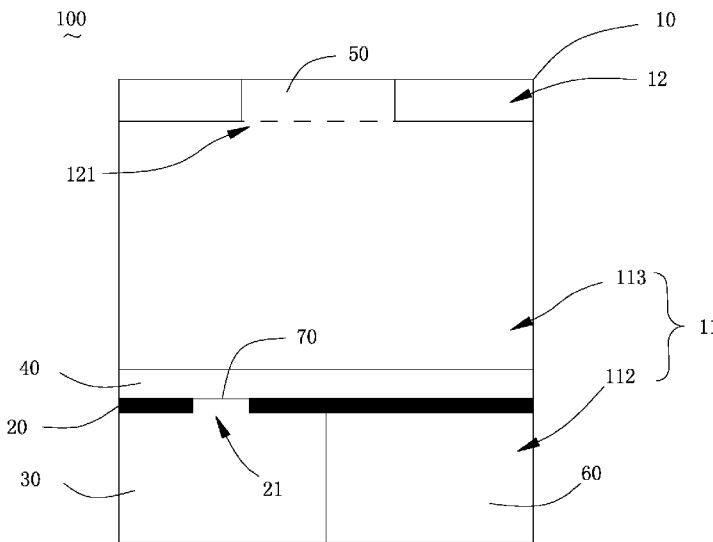


图 1

(57) Abstract: Disclosed in the present application is a cooking appliance, comprising a cavity, a base, a microwave assembly, a turntable assembly and a hot air assembly, wherein a chamber is formed in the cavity, and a plurality of through holes that are in communication with the chamber are formed in a first region of the cavity; the base is located in the chamber and divides the chamber into an accommodating space and a cooking space, and a first opening that is in communication with the accommodating space and the cooking space is formed in the base; the microwave assembly is located in the accommodating space and arranged corresponding to the first opening; the turntable assembly is arranged on the base; and the hot air assembly is located in the first region of the cavity, and hot air generated by the hot air assembly is introduced into the cooking space through the through holes. The cooking appliance further comprises a support assembly, which is arranged in the cooking space, is configured to support a baking tray, and is arranged close



BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

to the bottom of the cooking space. In addition, a microwave feed inlet is formed in a side wall of the cooking space, the microwave feed inlet is in communication with a microwave generation assembly, and at least part of the structure of the microwave feed inlet is located below the support assembly.

(57) 摘要: 本申请公开了一种烹饪器具, 烹饪器具包括腔体、底座、微波组件、转盘组件和热风组件, 腔体内形成有腔室, 腔体的第一区域开设有联通腔室的多个通孔, 底座位于腔室内, 并将腔室隔成收容空间和烹饪空间, 底座开设有连通收容空间和烹饪空间的第一开口, 微波组件位于收容空间内, 并与第一开口对应设置, 转盘组件设置于底座上, 热风组件位于腔体的第一区域, 热风组件产生的热风通过通孔传入烹饪空间。烹饪器具还包括支撑组件, 支撑组件设置于烹饪空间内, 并用于支撑烤盘, 且支撑组件靠近烹饪空间的底部设置; 烹饪空间的侧壁上设置有微波馈入口, 微波馈入口与微波发生组件连通, 且微波馈入口的至少部分结构位于支撑组件的下方。

烹饪器具

优先权信息

本申请要求以下专利申请的优先权和权益，其全部内容通过引用结合在本申请中：

2022 年 11 月 03 日提交至中国国家知识产权局的、申请号为 202211374046.0、名称为“烹饪器具”的中国专利申请。

2023 年 02 月 23 日提交至中国国家知识产权局的、申请号为 202310168007.3、名称为“烹饪器具”的中国专利申请。

技术领域

本申请涉及生活电器领域，尤其涉及一种烹饪器具。

背景技术

本部分提供的仅仅是与本公开相关的背景信息，其并不必然是现有技术。

烹饪器具，如微波炉、煎烤机等作为一种便捷的加热和蒸烤食物的厨具，因其使用的便捷性，越来越广泛地走进千家万户，成为不可或缺的厨房用品。

目前，微波炉的微波溃口布置于在腔体侧壁，然而，为了微波炉的美观性以及提高利用率，通常会将电器件放在底部，并采用下拉门的方式，若微波溃口布置于在腔体侧壁，影响层架设计，并且导波管

的装配会导致微波炉边框较厚，进一步降低微波炉的空间利用率低。

在烹饪器具的内部通常设置有烹饪空间，微波有转盘式和平板式两种馈入方式，其中，转盘式的烹饪器具的微波馈入口一般在烹饪空间的侧壁的中部设置。通过转盘带动食物，使食物可以均匀获得微波能量。

但是，现有技术中的烹饪器具的烹饪空间在放置烤盘时，通常需要将烤盘靠近烹饪空间的底部设置，出现了烤盘的加热效率较低甚至无法加热的情况。

发明内容

本申请提供一种烹饪器具。

本申请实施方式的烹饪器具，包括：

腔体，所述腔体内形成有腔室，所述腔体的第一区域开设有联通所述腔室的多个通孔；

底座，位于所述腔室内，并将所述腔室隔成收容空间和烹饪空间，所述底座开设有连通所述收容空间和所述烹饪空间的第一开口；

微波组件，位于所述收容空间内，并与所述第一开口对应设置；

转盘组件，设置于所述底座上；

热风组件，位于所述腔体的所述第一区域，所述热风组件产生的热风通过所述通孔传入所述烹饪空间。

如此，通过将微波组件设置于收容空间内，第一开口开设于底座，

转盘组件设置于底座上，热风组件设置于第一区域，使烹饪器具在实现转盘功能的情况下，可以减小烹饪器具两侧的占用空间，提高空间利用率。

在某些实施方式中，所述底座呈矩形，所述底座表面开设有第一凹槽，所述转盘组件收容于所述第一凹槽。

在某些实施方式中，所述转盘组件包括：

承载支架，安装于所述第一凹槽底面，包括环形本体和自所述环形本体伸出的多个支架；

托盘，安装于所述承载支架背离所述第一凹槽底面的一侧。

在某些实施方式中，所述第一开口呈方形，所述第一开口设置于所述第一凹槽的底面。

在某些实施方式中，所述底座还开设有与所述第一凹槽连通的第二凹槽。

在某些实施方式中，所述底座还包括第三凹槽和凸起，所述第三凹槽开设于所述第一凹槽的底面，所述凸起形成于所述第三凹槽内。

在某些实施方式中，所述烹饪器具还包括驱动电机，所述驱动电机设置于所述收容空间内，所述驱动电机至少部分从所述凸起向所述烹饪空间延伸以和所述转盘组件连接。

在某些实施方式中，所述微波组件包括波导组件和磁控管，所述波导组件包括第一部和自所述第一部一端弯折延伸的第二部，所述第一部设置在所述底座远离烹饪空间一侧，所述第二部与所述磁控管连接。

在某些实施方式中，所述烹饪器具还包括盖板，所述盖板盖设于所述第一开口上。

在某些实施方式中，所述第一开口包括多个。

本申请的目的是至少解决现有技中的烹饪器具的烹饪空间中放置烤盘后出现的烤盘的加热效率较低甚至无法加热的问题。该目的是通过以下技术方案实现的：

本申请提出了一种烹饪器具，所述烹饪器具包括烹饪空间和微波发生组件，所述烹饪器具还包括：

支撑组件，所述支撑组件设置于所述烹饪空间内，并用于支撑烤盘；

所述烹饪空间的侧壁设置有微波馈入口，所述微波馈入口与所述微波发生组件连通，且所述微波馈入口的至少部分结构位于所述支撑组件的下方。

根据本申请的烹饪器具，通过将微波馈入口设置在烹饪空间的侧壁上，并将微波馈入口的至少部分结构位于支撑组件的下方，则在烤盘放置在支撑组件上后，微波发生组件发生微波，通过微波馈入口进入的微波对烤盘进行加热，从而对烤盘内的食物加热，提高了对烤盘的加热效率。

另外，根据本申请的烹饪器具，还可具有如下附加的技术特征：

在本申请的一些实施例中，所述微波馈入口的全部结构位于所述支撑组件的下方。

在本申请的一些实施例中，所述烹饪器具还包括门体，所述微波

馈入口设置于所述侧壁远离所述门体的一侧。

在本申请的一些实施例中，所述烤盘为吸波烤盘。

在本申请的一些实施例中，所述烹饪器具还包括热风组件，所述热风组件用于产生吹向所述烹饪空间内的热风；

所述烹饪空间朝向所述热风组件的壁面上设有第一网孔，所述热风通过所述第一网孔进入所述烹饪空间。

在本申请的一些实施例中，所述侧壁的至少部分表面设置有第二网孔，所述第二网孔与所述热风组件相连通，所述第二网孔位于所述支撑组件的上方。

在本申请的一些实施例中，所述烹饪器具还包括波导组件，所述微波发生组件通过所述波导组件将微波输送到所述微波馈入口。

在本申请的一些实施例中，所述微波发生组件设置于所述波导组件的一侧，所述波导组件的微波出口与所述微波馈入口对应并连通设置。

在本申请的一些实施例中，所述烹饪器具还包括转盘组件，所述转盘组件包括驱动电机和支架，所述驱动电机的输出轴与所述支架传动连接；

所述支架上设置转动件，所述转动件设置于所述支架上。

在本申请的一些实施例中，所述支撑组件与所述烹饪空间底部之间的距离小于所述烹饪空间高度的 0.5 倍。

本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本申请的实践了解到。

附图说明

本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式
的描述中将变得明显和容易理解，其中：

图 1 是本申请实施方式的烹饪器具的布局示意图；

图 2 是本申请实施方式的底座的结构示意图；

图 3 是本申请实施方式的转盘组件的结构示意图；

图 4 是本申请实施方式的微波组件的结构示意图；

图 5 示意性地示出了根据本申请实施方式的烹饪器具的分解结
构示意图；

图 6 为图 5 中所示的烹饪器具的 A 处的局部放大图；

图 7 为图 5 中所示的烹饪器具的外罩处于第二视角的结构示意
图；

图 8 为图 5 中所示的烹饪器具的外罩处于第三视角的结构示意
图；

图 9 为图 5 中所示的烹饪器具的腔体处于第二视角的结构示意
图；

图 10 为图 5 中所示的烹饪器具的腔体处于第三视角的结构示意
图；

图 11 为图 5 中所示的烹饪器具的波导组件和微波发生组件处于
第二视角的结构示意图；

图 12 为图 5 中所示的烹饪器具的控制组件处于第二视角的结构
示意图；

图 13 为图 5 中所示的烹饪器具的安装板处于第二视角的结构示意图；

图 14 为图 5 中所示的烹饪器具的转盘组件和腔体的结构示意图（含支撑组件）；

图 15 为图 14 中所示的烹饪器具的转盘组件和腔体的分解结构示意图；

图 16 为烤盘的结构示意图。

主要元件符号说明：

100、烹饪器具；

10、腔体；11、腔室；112、收容空间；113、烹饪空间；114、顶板；1141、第一网孔；115、侧板；1151、微波馈入口；1152、第二网孔；116、底板；117、背板；12、第一区域；121、通孔；

20、底座；21、第一开口；22、第一凹槽；23、第二凹槽；24、第三凹槽；25、凸起；251、连接孔；

30、微波组件；31、波导组件；311、第一部；312、第二部；313、第三部；314、微波出口；32、磁控管；

40、转盘组件；41、承载支架；411、环形本体；412、支架；4121、转动件；42、托盘；

50、热风组件；

60、驱动电机；

70、盖板；

80、安装板；

90、支撑组件；

101、门体；102、铰链；103、外罩；1031、第一壳体；1032、第二壳体；1033、第三壳体；104、控制组件；

200、烤盘；201、本体层；202、微波换能发热层；203、翻边。

具体实施方式

下面详细描述本申请的实施方式，所述实施方式的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的，仅用于解释本申请，而不能理解为对本申请的限制。

在本申请的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，

可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接或可以相互通讯；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

在本申请中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开，下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然，它们仅仅为示例，并且目的不在于限制本申请。此外，本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母，这种重复是为了简化和清楚的目的，其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外，本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子，但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。

请参阅图 1，本申请提供了一种烹饪器具 100，烹饪器具 100 包括腔体 10、底座 20、微波组件 30、转盘组件 40 和热风组件 50，腔体 10 内形成有腔室 11，腔体 10 的第一区域 12 开设有联通腔室 11 的多个通孔 121，底座 20 位于腔室 11 内，并将腔室 11 隔成收容空间 112 和烹饪空间 113，底座 20 开设有连通收容空间 112 和烹饪空间 113 的第一开口 21，微波组件 30 位于收容空间 112 内，并与第一开口 21 对应设置，转盘组件 40 设置于底座 20 上，热风

组件 50 位于腔体 10 的第一区域 12，热风组件 50 产生的热风通过通孔 121 传入烹饪空间 113。

具体地，烹饪器具 100 可以是微波炉，在此不做限定，烹饪器具 100 用于烹饪食物，烹饪器具 100 包括腔体 10、底座 20、微波组件 30、转盘组件 40 和热风组件 50。腔体 10 可以呈矩形体设置，腔体 10 内形成有腔室 11。底座 20 可以呈矩形，底座 20 横向设置于腔室 11 内，底座 20 将腔室 11 分隔形成收容空间 112 和烹饪空间 113，其中，收容空间 112 可以用于容纳微波组件 30，微波组件 30 用于发射微波加热食物。烹饪空间 113 用于烹饪食物，转盘组件 40 可转动设置于底座 20 上，转盘组件 40 用于承装食物，在烹饪器具 100 烹饪食物的情况下，转盘组件 40 可以带动食物转动，使得食物可以均匀的获得微波能量。

腔体 10 还包括第一区域 12，第一区域 12 可以位于腔室 11 顶部，第一区域 12 开设有多个连通烹饪空间 113 的通孔 121。热风组件 50 设置于第一区域 12，热风组件 50 用于产生热风，热风通过多个通孔 121 进入烹饪空间 113，热风组件 50 可以加速烹饪空间 113 内空气流动，提高食物表面换热效率。

底座 20 开设有第一开口 21，第一开口 21 可以呈圆形、矩形等规则或不规则形，第一开口 21 连通收容空间 112 和烹饪空间 113，第一开口 21 为微波馈入口，第一开口 21 可以是一个，也可以是多个，本申请优选设置一个第一开口 21。微波组件 30 与第一开口 21 对应设置于收容空间 112 内，微波组件 30 产生的微波可以通过第一开口 21 进入烹饪空间 113，从而加热放置于转盘组件 40 的食物。

进一步地，在加热过程中，微波组件 30 发射微波通过第一开口 21 进入烹饪空间 113，转盘组件 40 位于底座 20 上持续转动，微波与食物均匀接触，可以对食物进行加热，同时，热风组件 50 产生的热风通过多个通孔 121 进入烹饪空间 113，热风与食物表面

接触，与食物产生热交换，从而加热食物。

如此，通过将微波组件 30 设置于收容空间 112 内，第一开口 21 开设于底座 20，转盘组件 40 设置于底座 20 上，热风组件 50 设置于第一区域 12，使烹饪器具 100 在实现转盘功能的情况下，可以减小烹饪器具 100 两侧的占用空间，提高空间利用率。

请参阅图 2，在某些实施方式中，底座 20 基本呈矩形，底座 20 表面开设有第一凹槽 22，所述转盘组件 40 收容于第一凹槽 22。

具体地，底座 20 包括第一凹槽 22，自底座 20 靠近烹饪空间 113 一面向收容空间 112 凹陷形成第一凹槽 22，第一凹槽 22 基本呈圆形，转盘组件 40 设置于第一凹槽 22 内，第一凹槽 22 包括底面和侧壁，转盘组件 40 的高度与第一凹槽 22 的深度相同，也即是，转盘组件 40 收容于第一凹槽 22 内，且与侧壁齐平。

如此，通过在底座 20 设置第一凹槽 22，可以使底座 20 收容转盘组件 40，第一凹槽 22 基本呈圆形设置，可以为转盘组件 40 提供转动空间。

请参阅图 2，在某些实施方式中，第一开口 21 呈方形，第一开口 21 设置于第一凹槽 22 的底面。

具体地，第一开口 21 可以设置于第一凹槽 22 的底面，在微波组件 30 发射的微波通过第一开口 21 进入烹饪空间 113 的情况下，微波可以传输至位于第一凹槽 22 内的转盘组件 40，从而加热位于转盘组件 40 上的食物。第一开口 21 呈方形设置，第一开口 21 可以是一个，也可以是多个，一个或多个第一开口 21 围绕第一凹槽 22 中心分布，微波组件 30 可以通过第一开口 21 传输微波至烹饪空间 113。

在一些示例中，第一凹槽 22 设置有多多个第一开口 21，多个第一开口 21 围绕第一凹槽 22 中心设置，微波组件 30 产生的微波通过多个第一开口 21 进入烹饪空间 113，可以提高烹饪器具 100 的微波性能，提升烹饪器具 100 的加热效率。

在另一些示例中，第一凹槽 22 设置一个第一开口 21，微波组件 30 产生的微波通过第一开口 21 进入烹饪空间 113，为食物提供微波能量，从而加热食物。相较于设置多个第一开口 21，设置一个第一开口 21 的底座 20，方便制造，可以提高烹饪器具 100 的生产效率。

如此，通过将第一开口 21 设置于第一凹槽 22 底面，可以使微波组件 30 发射的微波传输至转盘组件 40，从而对食物进行加热。

请参阅图 2，在某些实施方式中，底座 20 还开设有与第一凹槽 22 连通的第二凹槽 23。

具体地，底座 20 还可以开设有第二凹槽 23，第二凹槽 23 与第一凹槽 22 连通，第二凹槽 23 可以呈矩形、半圆形等规则或不规则形，本申请优选第二凹槽 23 呈半圆形设置，用户可以通过第二凹槽 23 取出转盘组件 40，对转盘组件 40 进行清洗或更换。用户还可以通过第二凹槽 23 安装清洗或更换后的转盘组件 40。

如此，底座 20 通过设置第二凹槽 23，可以方便用户取出或安装转盘组件 40。

请参阅图 3，在某些实施方式中，转盘组件 40 包括承载支架 41 和托盘 42，承载支架 41 安装于第一凹槽 22 底面，承载支架 41 包括环形本体 411 和自环形本体 411 伸出的多个支架 412，托盘 42 安装于承载支架 41 背离第一凹槽 22 底面的一侧。

具体地，转盘组件 40 的承载支架 41 可以是多脚支架，承载支架 41 用于承载托盘 42，承载支架 41 包括环形本体 411 和多个支架 412，多个支架 412 用于支撑托盘 42，支架 412 的数量可以是三个、四个等，相较于一个或两个支架 412，支架 412 数量大于两个可以更稳固的支撑托盘 42，支架 412 的具体数量在此不做限定，本申请以三个支架 412 为例，三个支架 412 可以是等间距或非等间距沿环形本体 411 分布，本申请优选等间距分布，多个支架 412 与环形本体 411 可以是一体成型结构，也可以是分体成型

结构，在此不做限定。

支架 412 可以包括转动件 4121，转动件 4121 位于支架 412 远离承载本体 411 一端，转动件 4121 呈圆柱体，转动件 4121 与支架 412 可转动连接，每个支架 412 通过一个转动件 4121 与托盘 42 卡接，当承载支架 41 转动时，可以带动托盘 42 转动。

托盘 42 可以呈圆形、矩形等规则或不规则形体，托盘 42 用于放置待烹饪的食物，托盘 42 可以由耐热玻璃制成，相较于金属制托盘 42，玻璃托盘 42 不吸收微波，可以使微波抵达食物，从而对食物进行加热。

如此，本申请的转盘组件 40 通过设置承载支架 41 和托盘 42，承载支架 41 支撑托盘 42，多个支架卡接托盘 42，当承载支架 41 转动时，可以带动托盘 42 转动，保持托盘 42 支撑的同时可以使食物均匀受热。

请参阅图 2，在某些实施方式中，底座 20 还包括第三凹槽 24 和凸起 25，第三凹槽 24 开设于第一凹槽 22 的底面，凸起 25 形成于第三凹槽 24 内。

具体地，底座 20 包括第三凹槽 24 和凸起 25，凸起 25 设置于第三凹槽 24 内，第三凹槽 24 设置于第一凹槽 22 的底面，第三凹槽 24 由第一凹槽 22 的底面向收容空间 112 凹陷形成，第三凹槽 24 可以收容滴入底座 20 的油水。凸起 25 自第三凹槽 24 朝向烹饪空间 113 设置，凸起 25 设置于第一凹槽 22 中心位置，凸起 25 可以防止第三凹槽 24 内收容的油水流入收容空间 112。

如此，一方面，通过设置第三凹槽 24 可以收容由于加热食物而流入底座 20 的油水，另一方面，通过设置凸起 25 可以防止油水流入收容空间 112。

请参阅图 1，在某些实施方式中，烹饪器具 100 还包括驱动电机 60，驱动电机 60 设置于收容空间 112 内，驱动电机 60 至少部分从凸起 25 向烹饪空间 113 延伸以和转盘组件 40 连接。

具体地，驱动电机 60 可以为转盘组件 40 提供动力，从而使承载支架 41 转动。驱动电机 60 设置于收容空间 112 内，驱动电机 60 和微波组件 30 并排放置。

在一些实施方式中，凸起 25 可以包括连接孔 251，驱动电机 60 可以部分穿过连接孔 251 进入烹饪空间 113，从而与转盘组件 40 连接，在驱动电机 60 与转盘组件 40 连接的情况下，启动驱动电机 60 可以使转盘组件 40 转动，使食物可以均匀获得微波能量。

如此，一方面，通过设置驱动电机 60，可以为转盘组件 40 提供动力，使承载支架 41 转动，从而使食物可以均匀获得微波能量。另一方面，驱动电机 60 和微波组件 30 并排设置于收容空间 112 内，有效的减小了烹饪器具 100 高度，使得结构更加紧凑，提高空间利用率。

请参阅图 4，在某些实施方式中，微波组件 30 包括波导组件 31 和磁控管 32，波导组件 31 包括第一部 311 和自第一部 311 一端弯折延伸的第二部 312，第一部 311 设置在底座 20 远离烹饪空间 113 一侧，第二部 312 与磁控管 32 连接。

具体地，波导组件 31 用于传输微波，波导组件 31 可以是金属管，微波无法穿透金属，使用金属管传输微波可以提高传输效率，且损耗较小。波导组件 31 包括第一部 311 和第二部 312，其中，第一部 311 用于输出微波，第二部 312 用于输入微波。第一部 311 位于底座 20 远离烹饪空间 113 一侧，并与底座 20 焊接连接，可以理解的是，第一部 311 对应第一开口 21 设置。波导组件 31 自第一部 311 一端弯折延伸形成第二部 312，第二部 312 与磁控管 32 连接。磁控管 32 是一种用来产生微波能的电真空器件，磁控管 32 通过第二部 312 将微波传输入波导组件 31，波导组件 31 内的微波经过第一部 311，并通过第一开口 21 进入烹饪空间 113 内。

如此，通过设置波导组件 31 和磁控管 32，且通过波导组件

31 的第一部 311 与底座 20 连接，第二部 312 与磁控管 32 连接，可以使磁控管 32 产生的微波通过波导组件 31 进入烹饪空间 113，从而对烹饪空间 113 内的食物进行加热。

请参阅图 1，在某些实施方式中，烹饪器具 100 还包括盖板 70，盖板 70 盖设于第一开口 21 上。

具体地，盖板 70 位于底座 20 上，并盖设第一开口 21，盖板 70 可以防止油水进入底座 20 后流入波导组件 31。盖板 70 可以是云母片，云母片可以被微波穿透且绝缘性高，不会因微波的作用而发生电磁反应也不会因微波的作用而发生质变。

如此，通过在底座 20 设置盖板 70 并盖设在第一开口 21，可以在不影响微波传输的情况下，防止油水进入波导组件 31。

如图 5 至图 16 所示，根据本申请的实施方式，提出了一种烹饪器具 100，如图 5、图 6，以及图 9 和图 10 所示，其中，图 5 示意性地示出了根据本申请实施方式的烹饪器具 100 的分解结构示意图，图 6 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的 A 处的局部放大图，图 9 为图 1 中所示的烹饪器具 100 的腔体 10 处于第二视角的结构示意图，图 10 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的腔体 10 处于第三视角的结构示意图。烹饪器具 100 包括烹饪空间 113，其中，烹饪空间 113 内用于放置食物，烹饪器具 100 还包括微波发生组件和转盘组件 40，转盘组件 40 包括转盘，转盘上用于放置待加热的食物，其中，转盘设置于烹饪空间 113 的底部，且转盘可转动地设置于烹饪空间 113 的内部。这里的烹饪器具 100 除了具有烹饪空间 113 和转盘组件 40 外，烹饪器具 100 还包括支撑组件 90，支撑组件 90 设置于烹饪空间 113 内，用于支撑烤盘 200，这里的烤盘 200 的作用和托盘 42 的作用是相同的，烹饪空间 113 的侧板 115 上设置有微波馈入口 1151，微波发生组件与微波馈入口 1151 连通，且微波馈入口 1151 的至少部分结构位于支撑组件的下方。

需要说明的是，这里的微波馈入口 1151 和第一开口 21 均可

以实现微波馈入的效果，但是二者设置的位置是不同的，本实施例中的微波馈入口 1151 可以代替前面实施例中的第一开口 21。

本申请中的烹饪器具 100，通过将微波馈入口 1151 设置在烹饪空间 113 的侧板 115 上，并将微波馈入口 1151 的至少部分结构位于支撑组件 90 的下方，则在烤盘 200 放置在支撑组件 90 上后，可以通过微波馈入口 1151 将微波发生组件发生的微波输送到烹饪空间 113 中，对烤盘 200 进行加热，从而对烤盘 200 内的食物加热，提高了对烤盘 200 的加热效率。

需要说明的是，现有技术中的微波馈入口 1151 通常是设置在烹饪空间 113 的顶部或者侧部，微波通过微波馈入口 1151 向烹饪空间 113 内输送微波，同时安装在烹饪空间 113 的底部的转盘进行旋转，从而对放在转盘上的食物进行加热。但是，这种结构只能对放置在转盘上的食物进行加热，导致烹饪器具 100 的功能单一，无法实现烘烤和煎炸等功能。而将烤盘 200 直接放在烹饪空间 113 的内部，烤盘 200 吸收的热量较少，无法对烤盘 200 内的食物进行有效加热，且烤盘 200 上方放置食物的空间较小，无法放入足够的食物，因此，需要对此进行改进。

在前文中，我们提到了将微波馈入口 1151 的至少部分结构位于支撑组件 90 的下方，也就是位于支撑组件 90 与转盘组件 40 之间，则可以使得微波馈入口 1151 进入的至少微波对烤盘 200 进行加热，该部分微波位于烤盘 200 的下方，从而对烤盘 200 内的食物进行加热，当然，也会有部分微波进入到高于烤盘 200 的空间内，无法对这些微波进行充分利用。

需要说明的是，这里的支撑组件 90 是设置于烹饪空间 113 的下部，从而可以使得烤盘 200 在放置到支撑组件 90 后，烤盘 200 上方有足够的空间去放置食物。

为了提高对微波的利用率，作为一种可选的方式，微波馈入口 1151 的全部结构位于支撑组件 90 和转盘之间，此时，通过微

波馈入口 1151 进入的微波除了可以对转盘上的食物进行加热外，还可以对烤盘 200 进行加热，从而可以充分利用微波，提高对微波的利用率，减少浪费。

此外，通过将微波馈入口 1151 的全部结构位于支撑组件 90 和转盘之间，可以避免出现微波馈入口 1151 出现被遮挡的情况，使得微波进入烹饪空间 113 的时候不会受到阻碍，提高了微波的输送效率。

这里的微波馈入口 1151 可以是支撑组件 90 分隔开的两个通孔，也可以是一个通孔，当微波馈入口 1151 的全部结构位于支撑组件 90 和转盘之间时，微波馈入口 1151 为一个通孔。

需要说明的是，这里的支撑组件 90 可以是凸起的结构，如将侧板 115 通过冲压工艺形成凸起的结构，此时支撑组件 90 和侧板 115 为一体的结构，不易出现脱落的情况。这里的支撑组件 90 也可以是支撑杆等独立的结构，与侧板 115 之间为分体的结构，通过将支撑组件 90 设置在侧板 115 的内表面，如采用焊接的结构或者粘结等结构进行固定。

需要说明的是，这里的支撑组件 90 的数量可以为两个，分别设在两个侧板 115 上，两个支撑组件 90 处于同一个高度位置，从而可以使得烤盘 200 呈水平放置。支撑组件 90 的数量也可以为三个，其中两个支撑组件 90 设置在两个侧板 115 的内表面，还有一个支撑组件 90 设置在背板 117 的内表面，三个支撑组件 90 处于同一个高度位置，从而可以使得烤盘 200 呈水平放置。

需要说明的是，这里的微波馈入口 1151 的形状可以是矩形的通孔，也可以是圆形的通孔、椭圆形的通孔或者梯形的通孔等，均可以实现微波通过微波馈入口 1151 进入烹饪空间 113 的效果。

这里的烹饪空间 113 是通过腔体 10 合围后形成的，其中，腔体 10 包括顶板 114、侧板 115 和底板 116，其中，侧板 115 的数量为两个，分别设置于烹饪空间 113 在宽度方向的两侧，也就是

图 1 中烹饪空间 113 的左侧和右侧两个方向，两个侧板 115 均与顶板 114 和底板 116 连接，顶板 114、两个侧板 115 和底板 116 合围后形成矩形的筒状结构，其中，底板 116 上设置有转盘组件 40。

可选地，烤盘 200 为吸波烤盘，且烤盘 200 为可拆卸结构。具体地，如图 16 所示，其中，图 16 为烤盘 200 的结构示意图。烤盘 200 包括本体层 201，本申请中可以在本体层 201 的底部的外表面和/或侧部的外表面设置微波换能发热层 202 来实现，优选的方案是将微波换能发热层 202 设置于本体层 201 的底部的外表面和侧部靠近底部的外表面位置，也就是说，在本体层 201 的底部的外表面和侧部的下部分的外表面均微波换能发热层 202 来实现对微波的吸收，从而可以实现对烤盘 200 内食物的加热效果。

当然，这里的微波换能发热层 202 也可以设置在本体层 201 的底部的外表面和烤盘 200 的侧部的外表面，可以从烤盘 200 的底部和侧部同时对烤盘 200 内的食物进行加热，提高对食物的加热效率。另外，这里的微波换能发热层 202 的材质为碳化硅、铁氧体或者氧化锌等，具有良好的吸热性能，可以通过在烤盘 200 的外表面采用喷涂工艺实现。

需要说明的是，这里的微波换能发热层 202 的厚度不易过厚，以避免部分微波换能发热层 202 出现脱落的情况，但是，厚度也不易太薄，镀层的厚度太小将会影响烤盘 200 的吸热性能。通常，可以将微波换能发热层 202 的厚度设置为本体层 201 厚度的 0.1 至 0.9 倍，如微波换能发热层 202 的厚度具体为本体层 201 的厚度的 0.5 倍或者 0.6 倍。当然，这里的微波换能发热层 202 也可以依靠载体，采用压力焊等焊接的方式覆盖在烤盘 200 的外表面。

继续参照图 16，这里的烤盘 200 的形状为矩形盘状结构，烤盘 200 在开口的四周具有翻边 203，可以通过将翻边 203 放置在支撑组件 90 上，从而实现烤盘 200 在烹饪空间 113 中的放置。通过设置翻边 203，可以避免烤盘 200 的外侧面和外底面被遮盖，提高

对微波的吸收效率，从而提高烤盘 200 的加热效率。这里所提到的烤盘 200 的外侧面是指与侧板 115 相对的表面，这里的外底面是指与烹饪空间 113 的底部相对的表面，这些位置均不与食物接触。

另外，这里的烤盘 200 通常是采用可拆卸的结构放置在烹饪空间 113 中，如可以直接将烤盘 200 放置在支撑组件 90 上，其中，支撑组件 90 的数量为两个，分别设置在两个侧板 115 上，这里将烤盘 200 直接放置在支撑组件 90 上，可以方便将烤盘 200 从烹饪空间 113 中取出，方便对烤盘 200 进行清洗，保持干净和卫生。

可选地，烹饪器具 100 还包括热风组件 50，热风组件 50 设置于烹饪空间 113 的一侧，用于产生吹向烹饪空间 113 内的热风，烹饪空间 113 朝向热风组件的设有第一网孔 1141，热风通过第一网孔 1141 进入烹饪空间 113。

需要说明的是，这里的热风组件 50 包括风机和加热部件等，风机产生的风经过加热部件的加热后变成热风，热风通过第一网孔 1141 进入到烹饪空间 113 的内部，对烹饪空间 113 的食物进行加热。这里的加热部件可以是加热管或者加热丝等产品。其中，这里的风机和加热部件都是现有技术中的常见产品，这里不再展开赘述。

需要说明的是，这里的热风组件 50 可以设置于烹饪空间 113 的顶部，此时，形成烹饪空间 113 的腔体 10 的顶壁顶板 114 设置有第一网孔 1141，热风通过第一网孔 1141 进入烹饪空间 113 的内部。这里的第一网孔 1141 为多个间隔设置的通孔，形状可以是圆形孔，也可以是方形孔等形状。通过将热风组件 50 设置于烹饪空间 113 的顶部，可以通过热风从烤盘 200 的上方对烤盘 200 内的食物进行加热，同时通过烤盘 200 本身对烤盘 200 内的食物进行加热，从而形成对食物进行多个方向的加热，提高对食物的加热效率，且在对烤盘 200 内的食物进行加热的过程中，不需要对食

物进行搅拌或者翻面，可以提高对食物加热的均匀性，方便使用者操作。

这里烤盘 200 对食物的加工方式可以是烘烤模式，也可以是煎炸等模式，使得烹饪器具 100 能够具有更多可供选择的加工类型，提高了烹饪器具 100 的多功能性，除了传统的加热食物外，还具有烘烤模式和煎炸模式中的至少一个。

可以理解的是，这里的热风组件 50 除了设置于烹饪空间 113 的上部外，也可以设置在烹饪空间 113 的侧面，如设置在烹饪空间 113 的左侧或者右侧，也可以同时设置在烹饪空间 113 的左侧和右侧，此时，第一网孔 1141 设置在腔体 10 的侧板 115 上，形成从烹饪空间 113 的侧面进热风的结构。

这里优选的方式是从烹饪空间 113 的左侧和右侧同时进风的结构，这样，可以从更多的方向对食物进行加热，提高对烤盘 200 内的食物的加热效率，使得烤盘 200 内的食物能够更快地食用。

下面将继续针对腔体 10 的具体结构进行展开阐述。

可选地，侧板 115 的至少部分表面设置有第二网孔 1152，第二网孔 1152 位于支撑组件 90 的上方，其中，第二网孔 1152 的数量为多个，多个第二网孔 1152 间隔设置，可以均匀设置，也可以是非均匀设置的方式。

另外，这里的第二网孔 1152 均位于支撑组件 90 的上方，可以对食物加热后产生的水蒸气排出；如图 14 和图 15 所示，图 14 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的转盘组件 40 和腔体 10 的结构示意图（含支撑组件 90），图 15 为图 14 中所示的烹饪器具 100 的转盘组件 40 和腔体 10 的分解结构示意图。侧板 115 的数量为两个，且两个侧板 115 为间隔设置，两个侧板 115 之间形成烹饪空间 113，在侧板 115 位于支撑组件 90 的上方位置有第二网孔 1152，也就是在侧板 115 的上半部分设置有第二网孔 1152。可以理解的是，这里的第二网孔 1152 可以只设置在其中的一个侧板 115 上，

也可以同时设置在两个侧板 115 上，在图 10 中，两个侧板 115 上均设置有第二网孔 1152，方便从两侧同时排出水蒸气。

需要说明的是，这里的腔体 10 还包括背板 117，其中，顶板 114 位于烹饪空间 113 的顶部，底板 116 位于烹饪空间 113 的底部，背板 117 位于烹饪空间 113 的后部，顶板 114、底板 116、背板 117 和侧板 115 合围形成烹饪空间 113。这里的腔体 10 围成的形状为矩形结构，也可以采用圆形结构或者其他形状的结构。

可选地，如图 5 和图 11 所示，其中，图 11 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的波导组件 31 和微波发生组件处于第二视角的结构示意图，烹饪器具 100 还包括微波发生组件和波导组件 31，微波发生组件通过波导组件 31 将微波输送到微波馈入口 1151，然后进入烹饪空间 113 的内部，这里的微波发生组件可以是磁控管 32，也可以是其他产生微波的组件，这里的波导组件 31 包括第一部 311、第二部 312 和第三部 313，其中，第一部 311 与微波发生组件连接，第三部 313 处于竖直方向，第三部 313 上设置有微波出口 314，微波出口 314 与腔体 10 的侧板 115 上的微波馈入口 1151 对应设置，可以使得微波为微波出口 314 进入到微波馈入口 1151 内，实现微波的传导。

可以理解的是，这里的微波发生组件和第二部 312 均位于烹饪空间 113 的下方，其中，这里的第三部 313 位于烹饪空间 113 的右侧，当然，这里的微波发生组件和第二部 312 也可以设置于烹饪空间 113 的一侧或者设置于烹饪空间 113 的顶部，这里不再进行展开赘述。

需要补充的是，这里的波导组件 31 可以采用焊接的方式固定在底板 116 上，底板 116 上设置有避让孔，避让孔内安装有转盘组件 40。

可选地，微波发生组件设置于波导组件 31 的一侧，具体是微波发生组件设置于波导组件 31 的左侧，波导组件 31 的微波出口

314 与微波馈入口 1151 对应并连通设置。需要说明的是，这里的微波出口 314 的形状与微波馈入口 1151 的形状是一致的，微波出口 314 与微波馈入口 1151 可以均为矩形通孔，微波出口 314 与微波馈入口 1151 也可以同时采用圆形孔或者同时采用椭圆形孔等形状。

下面将对转盘组件 40 的具体结构进行介绍，如图 14 和图 15 所示，其中，图 14 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的转盘组件 40 和腔体 10 的结构示意图（含支撑组件 90）；图 15 为图 14 中所示的烹饪器具 100 的转盘组件 40 和腔体 10 的分解结构示意图。转盘组件 40 除了转盘（未图示）外，还具有驱动电机 60 以及支架 412，驱动电机 60 的输出轴与支架 412 传动连接；支架 412 上设置转动件 4121，转盘设置于支架 412 上，其中，转盘通常为圆环形的盘状机构，可以将待加热的食物放置在转盘中，通过转盘的转动实现对转盘内的食物进行加热。

需要说明的是，这里的驱动电机 60 设置于烹饪空间 113 底部的中心位置，驱动电机 60 的输出轴穿过底板 116 后进入烹饪空间 113，支架 412 套在输出轴上，转盘放置在支架 412 上，通过在支架 412 上设置的转动件 4121 实现转盘在烹饪空间 113 内的转动。

这里的支架 412 为三叉结构，每个叉靠近端部的位置设置有转动件 4121，转动件 4121 的总数量为三个，用于使得转盘进行转动。

可选地，这里的微波馈入口 1151 的上方设置有云母片，防止油水进入波导组件 31 的内部，这里的云母片的可以采用现有技术中的云母结构，可以起到阻挡油水的结构即可。

可选地，支撑组件 90 与所述烹饪空间 113 的底部的距离小于所述烹饪空间 113 高度的 0.5 倍，也就是说，支撑组件 90 与所述烹饪空间 113 的底部的距离为所述烹饪空间 113 高度的 0.3 倍或者 0.4 倍等，支撑组件 90 在烹饪空间 113 中更靠近烹饪空间 113

的底部设置，从而可以使得支撑组件 90 的上方具有更多的空间。

可以理解的是，支撑组件 90 靠近烹饪空间 113 的底部设置是相对于烹饪空间 113 的顶部而言的，这里将支撑组件 90 更靠近烹饪空间 113 的底部设置，可以使得支撑组件 90 上放置的烤盘 200 可以具有更多容纳食物的空间，可以盛放更多的食物。

可选地，烹饪器具 100 还包括门体 101，门体 101 设置于烹饪器具 100 的一侧，微波馈入口 1151 设置于侧板 115 远离门体 101 的一端，其中，门体 101 位于烹饪器具 100 的前部，这里的微波馈入口 1151 设置于侧板 115 的后部，结合前面所描述的情况，可以确定这里的微波馈入口 1151 设置在侧板 115 靠近下端并靠近后端的位置，其中，将微波馈入口 1151 靠近侧板 115 的底部的位置，可以使得支撑组件 90 的设置位置尽量靠近烹饪空间 113 的底部，从而可以使得放置在支撑组件 90 上的烤盘 200 能够具有更多容纳食物的空间，增加烤盘 200 盛放的食物体积。另外，这里将微波馈入口 1151 靠近侧板 115 的后端设置，可以避开支架 412 和驱动电机 60 等部件，避免影响转盘的转动。

当然，在不影响转盘组件 40 的前提下，也可以将微波馈入口 1151 设置在侧板 115 靠近门体 101 的一端。

可选地，如图 5、图 12 和图 13 所示，图 12 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的控制组件 104 处于第二视角的结构示意图，图 13 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的安装板 80 处于第二视角的结构示意图。烹饪器具 100 还包括控制组件 104 和安装板 80，控制组件 104 设置于安装板 80 上，安装板 80 设置于烹饪器具 100 的底部。其中，控制组件 104 包括控制板，实现对烹饪器具 100 的自动控制，可以放置在电控盒中。这里的安装板 80 位于烹饪器具 100 的底部，且和门体 101 之间铰接。这里的门体 101 与安装板 80 之间可以采用铰链 102 进行连接，方便使用者通过打开门体 101，露出烹饪空间 113，方便将烤盘 200 和转盘以及食物放置在烹饪空间

113 中。

在本申请的一些实施例中，其中，图 7 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的外罩 103 处于第二视角的结构示意图，图 8 为图 5 中所示的烹饪器具 100 的外罩 103 处于第三视角的结构示意图，烹饪器具 100 还包括外罩 103，外罩 103 和腔体 10 之间形成收容空间 112，收容空间 112 位于腔体 10 的顶部，这里的外罩 103 包括依次连接的第一壳体 1031、第二壳体 1032 和第三壳体 1033，其中，第一壳体 1031 和第二壳体 1032 垂直设置，第二壳体 1032 和第三壳体 1033 垂直设置，外罩 103 呈半工字型结构，罩盖在腔体 10 的外侧。其中，热风组件 50 设置在收容空间 112 的内部。

本申请中的烹饪器具 100，在腔体 10 外部的两侧无电控元件，所有的电控元件均设置在控制组件 104 上，可以减小边框所占用的空间，使得烹饪器具 100 所占用的体积减小。

另外，本申请中的烹饪器具 100，热风组件 50 设置于腔体 10 的上部，转盘组件 40 设置在烹饪空间 113 的底部，除了具有微波对转盘内的食物进行加热外，可以通过烤盘 200 实现对食物的烤、煎或者炸等功能，扩展了烹饪器具 100 的使用场景和功能。

本申请中的烹饪器具 100，转盘和烤盘 200 同时使用，也可以分别使用，这里不做具体限定。在只使用转盘的时候，烹饪器具 100 的热风组件 50 通过第一网孔 1141 将热风吹入烹饪空间 113，从食物的上方进行加热，同时从微波馈入口 1151 进入的微波进入烹饪空间 113 后，食物可以通过转盘在烹饪空间 113 中的均匀旋转，使得转盘上的食物能够均匀地获得微波能量。在只使用烤盘 200 时，烹饪器具 100 的热风组件 50 通过第一网孔 1141 将热风吹入烹饪空间 113，从食物的上方进行加热，同时从微波馈入口 1151 进入的微波进入烹饪空间 113 后，通过烤盘 200 吸收微波，同时从食物的下方对食物进行加热，不需要翻滚食物或者手动翻面，且提高了对食物的加热效率。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施方式”、“某些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。

尽管已经示出和描述了本申请的实施方式，本领域的普通技术人员可以理解：在不脱离本申请的原理和宗旨的情况下可以对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，本申请的范围由权利要求及其等同物限定。

权 利 要 求 书

1. 一种烹饪器具，其特征在于，包括：

腔体，所述腔体内形成有腔室，所述腔体的第一区域开设有联通所述腔室的多个通孔；

底座，位于所述腔室内，并将所述腔室隔成收容空间和烹饪空间，所述底座开设有连通所述收容空间和所述烹饪空间的第一开口；

微波组件，位于所述收容空间内，并与所述第一开口对应设置；

转盘组件，设置于所述底座上；

热风组件，位于所述腔体的所述第一区域，所述热风组件产生的热风通过所述通孔传入所述烹饪空间。

2. 根据权利要求 1 所述的烹饪器具，其特征在于，所述底座呈矩形，所述底座表面开设有第一凹槽，所述转盘组件收容于所述第一凹槽。

3. 根据权利要求 2 所述的烹饪器具，其特征在于，所述转盘组件包括：

承载支架，安装于所述第一凹槽底面，包括环形本体和自所述环形本体伸出的多个支架；

托盘，安装于所述承载支架背离所述第一凹槽底面的一侧。

4. 根据权利要求 2 所述的烹饪器具，其特征在于，所述第一开口呈方形，所述第一开口设置于所述第一凹槽的底面。

5. 根据权利要求 2 所述的烹饪器具，其特征在于，所述底座还开设有与所述第一凹槽连通的第二凹槽。

6. 根据权利要求 2 所述的烹饪器具，其特征在于，所述底座还包括第三凹槽和凸起，所述第三凹槽开设于所述第一凹槽的底面，所述凸起形成于所述第三凹槽内。

7. 根据权利要求 6 所述的烹饪器具，其特征在于，所述烹饪器具还包括驱动电机，所述驱动电机设置于所述收容空间内，所述驱动电机至少部分从所述凸起向所述烹饪空间延伸以和所述转盘组件连接。

8. 根据权利要求 1 所述的烹饪器具，其特征在于，所述微波组件包括波导组件和磁控管，所述波导组件包括第一部 and 自所述第一部一端弯折延伸的第二部，所述第一部设置在所述底座远离烹饪空间一侧，所述第二部与所述磁控管连接。

9. 根据权利要求 1 所述的烹饪器具，其特征在于，所述烹饪器具还包括盖板，所述盖板盖设于所述第一开口上。

10. 根据权利要求 1 所述的烹饪器具，其特征在于，所述第一开口包括多个。

11. 一种烹饪器具，所述烹饪器具包括烹饪空间和微波发生组件，其特征在于，所述烹饪器具还包括：

支撑组件，所述支撑组件设置于所述烹饪空间内，并用于支撑烤盘；

所述烹饪空间的侧壁设置有微波馈入口，所述微波馈入口与所述微波发生组件连通，且所述微波馈入口的至少部分结构位于所述支撑组件的下方。

12. 根据权利要求 11 所述的烹饪器具，其特征在于，所述微波馈入口的全部结构位于所述支撑组件的下方。

13. 根据权利要求 11 所述的烹饪器具，其特征在于，所述烹饪器具还包括门体，所述微波馈入口设置于所述侧壁远离所述门体的一侧。

14. 根据权利要求 11 所述的烹饪器具，其特征在于，所述烤盘为吸波烤盘。

15. 根据权利要求 11 所述的烹饪器具，其特征在于，所述烹饪器具还包括热风组件，所述热风组件用于产生吹向所述烹饪空间内的热风；

所述烹饪空间朝向所述热风组件的壁面上设有第一网孔，所述热风通过所述第一网孔进入所述烹饪空间。

16. 根据权利要求 15 所述的烹饪器具，其特征在于，所述侧壁的至少部分表面设置有第二网孔，所述第二网孔与所述热风组件相连通，所述第二网孔位于所述支撑组件的上方。

17. 根据权利要求 11 所述的烹饪器具，其特征在于，所述烹饪器具还包括波导组件，所述微波发生组件通过所述波导组件将微波输送到所述微波馈入口。

18. 根据权利要求 17 所述的烹饪器具，其特征在于，所述微波发生组件设置于所述波导组件的一侧，所述波导组件的微波出口与所述微波馈入口对应并连通设置。

19. 根据权利要求 11 所述的烹饪器具，其特征在于，所述烹饪器具还包括转盘组件，所述转盘组件包括驱动电机和支架，所述驱动电机的输出轴与所述支架传动连接；

所述支架上设置转动件，所述转动件设置于所述支架上。

20. 根据权利要求 11 所述的烹饪器具，其特征在于，所述支撑组件与所述烹饪空间底部之间的距离小于所述烹饪空间高度的 0.5 倍。

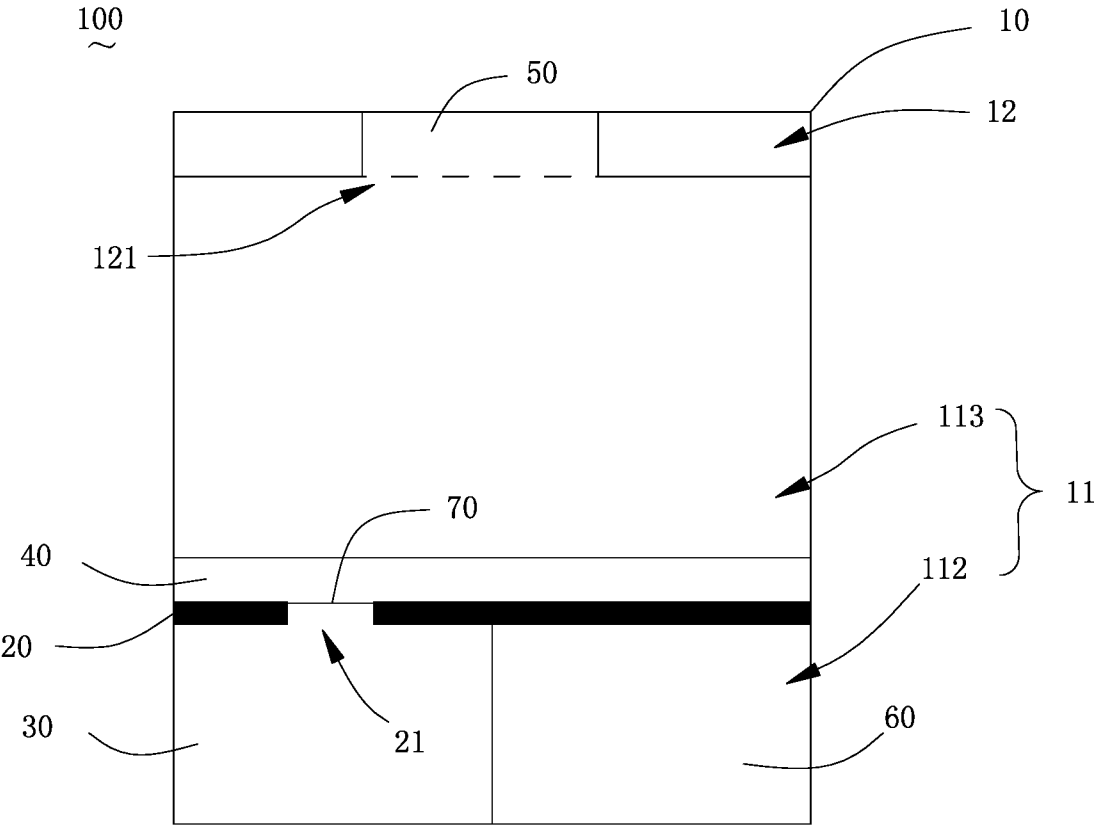


图 1

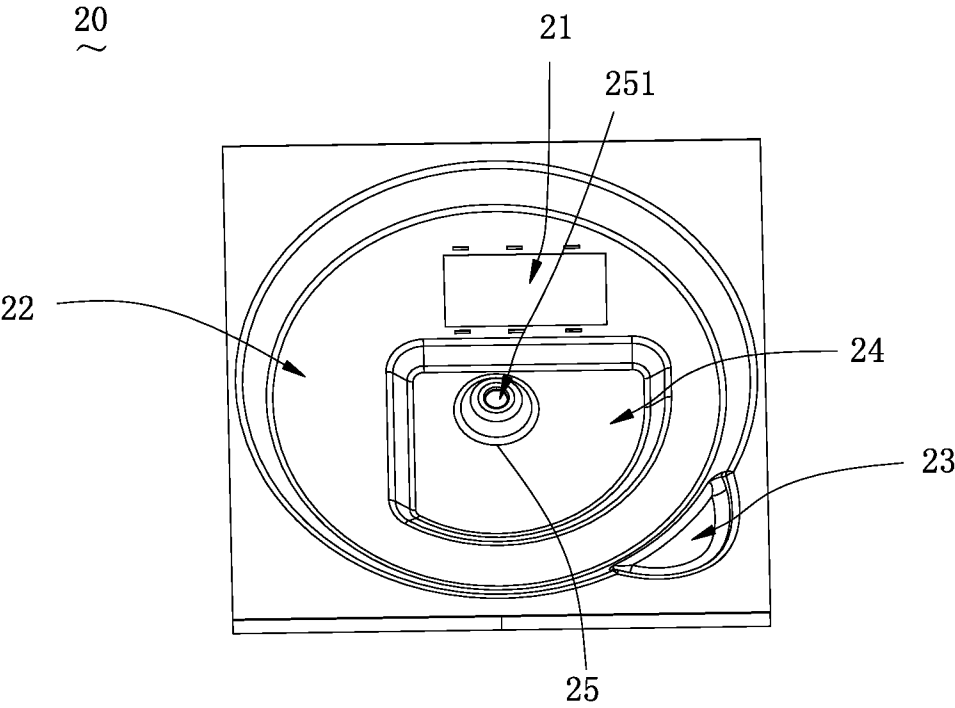


图 2

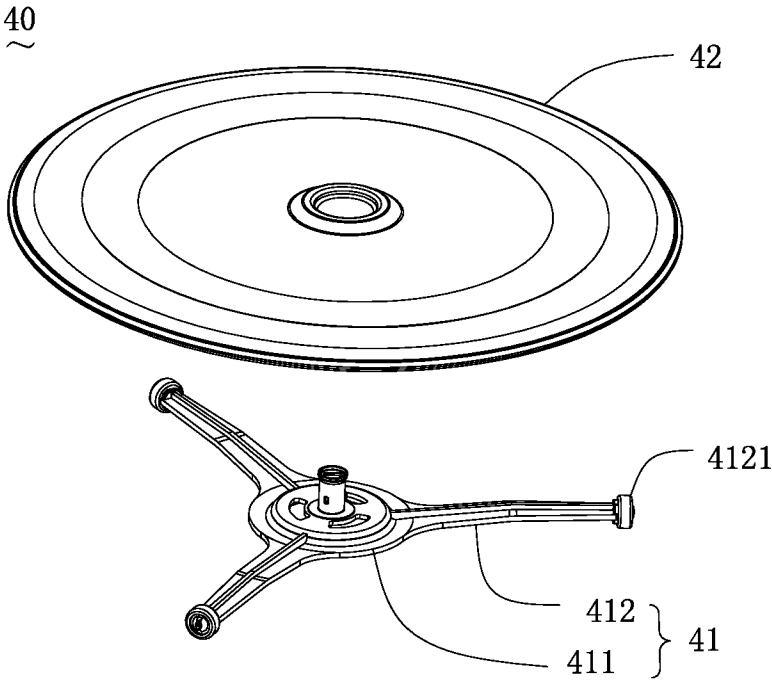


图 3

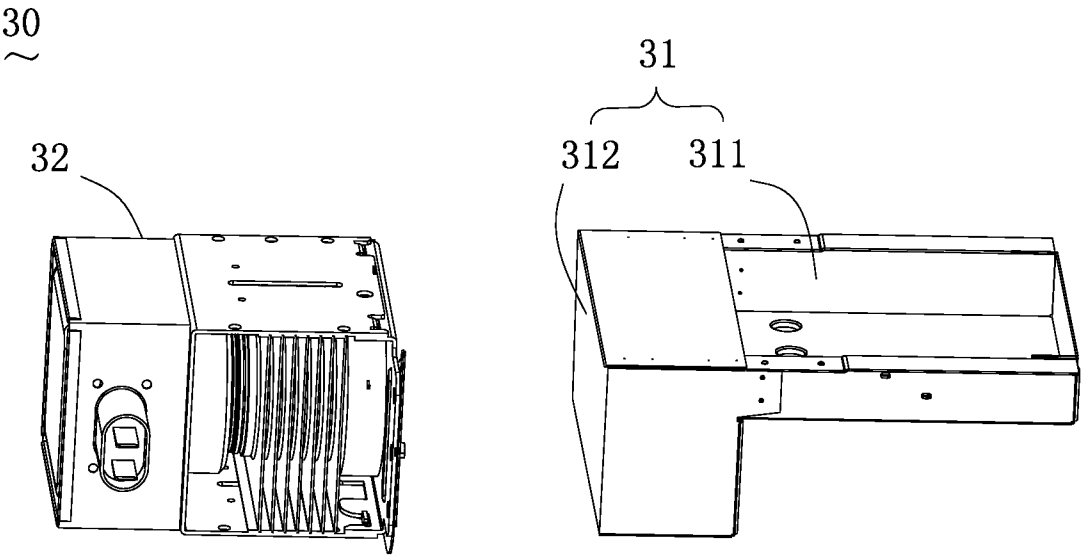


图 4

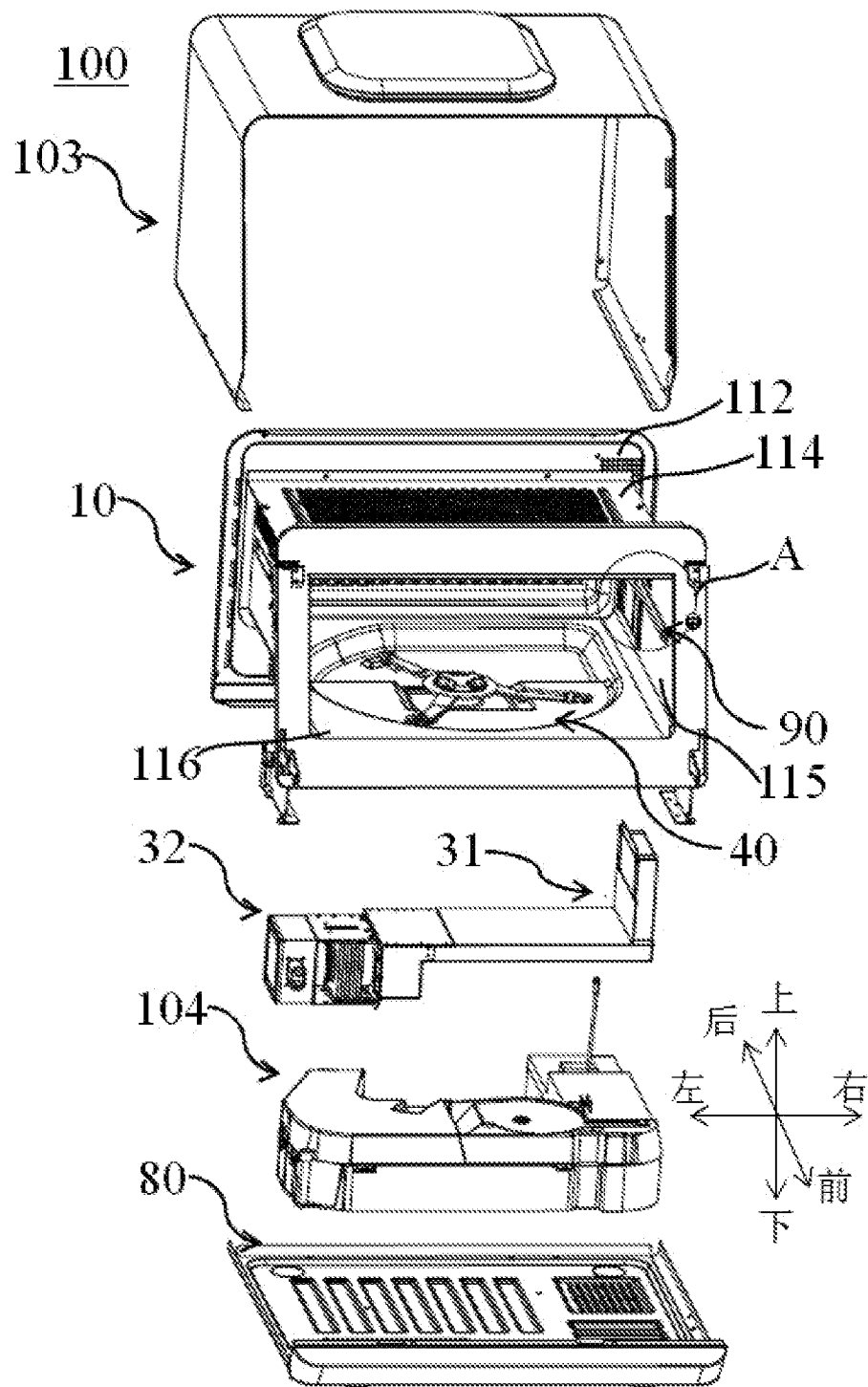


图 5

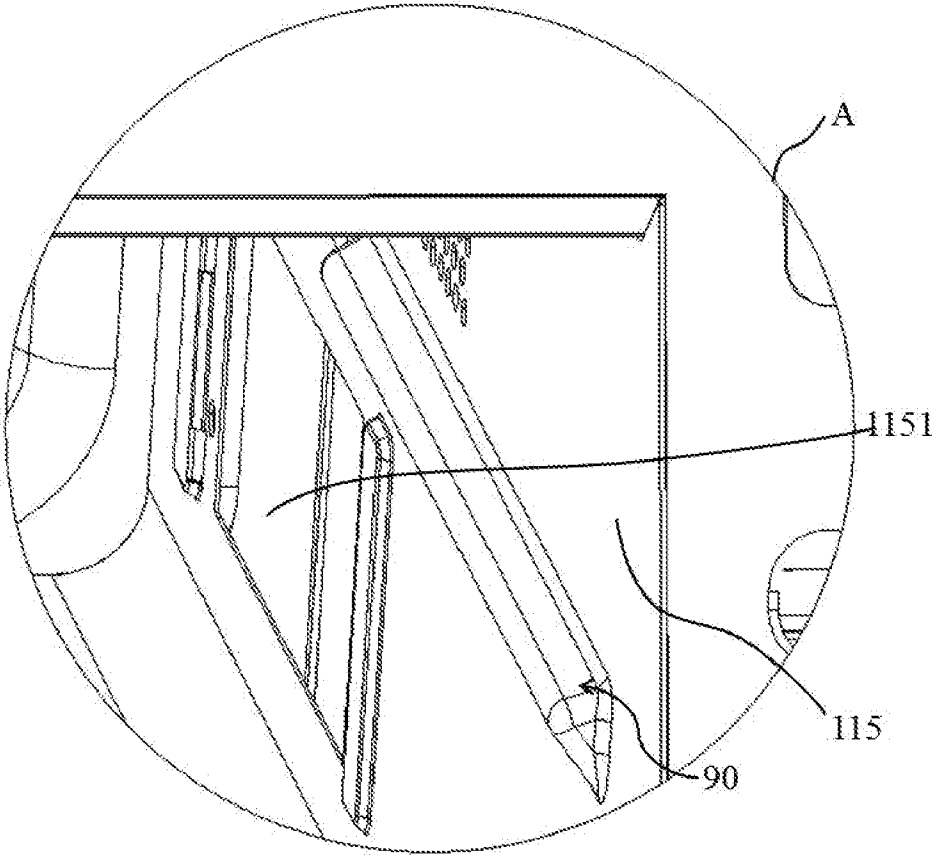


图 6

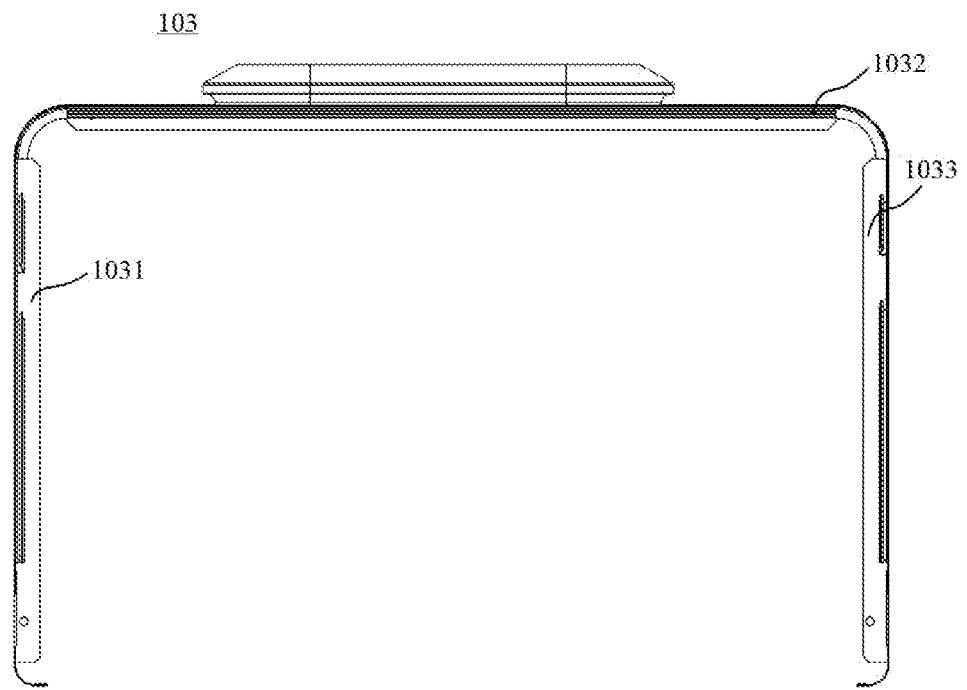


图 7

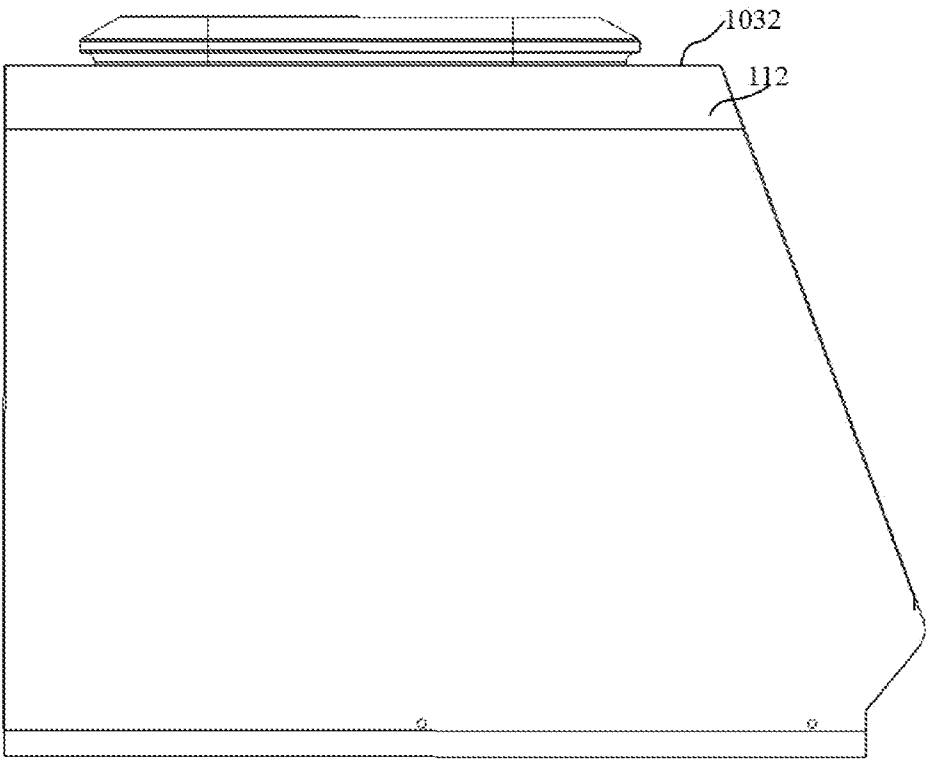


图 8

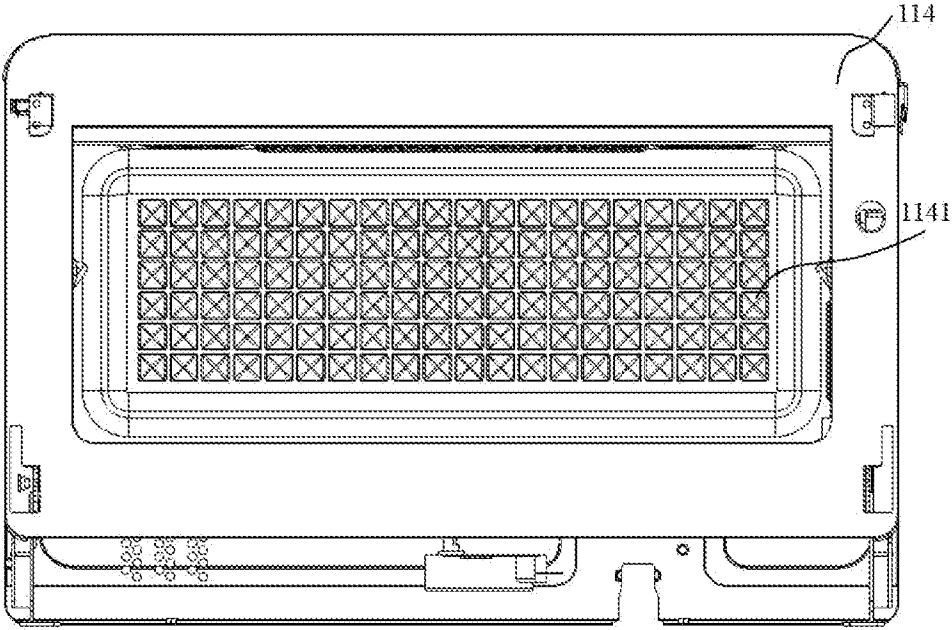


图 9

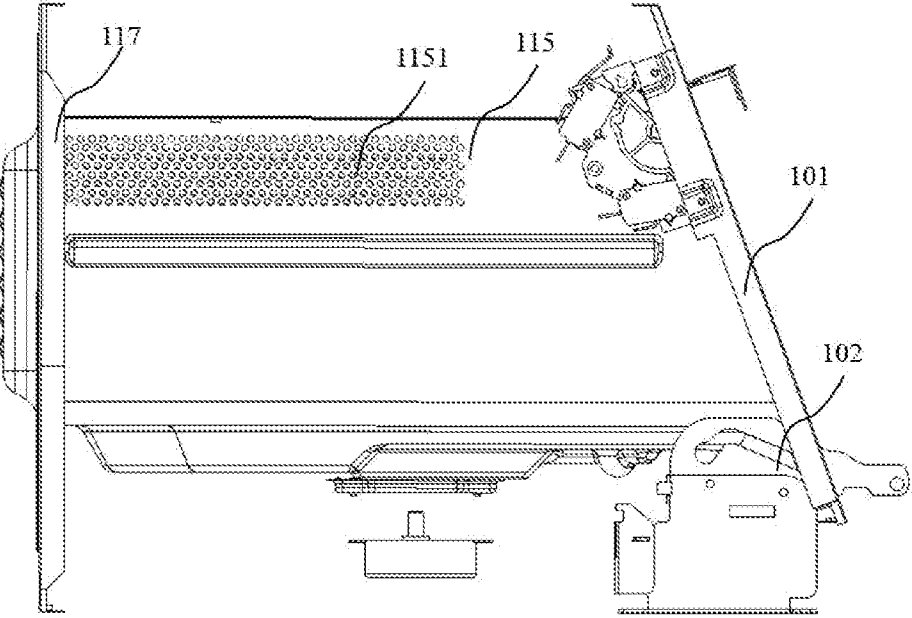


图 10

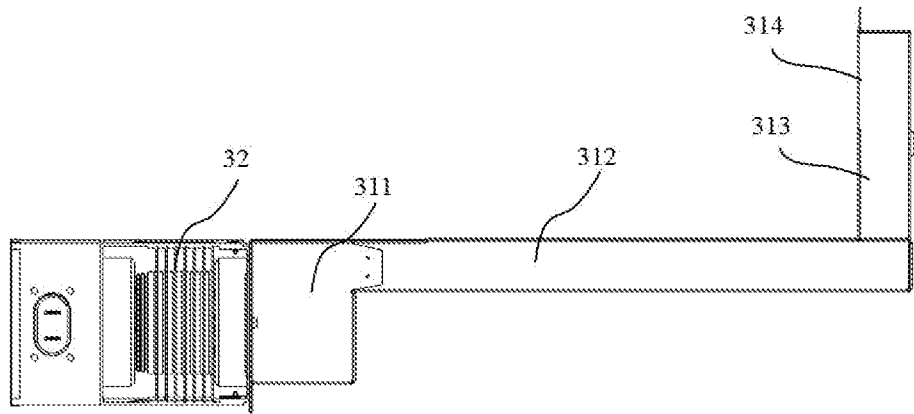


图 11

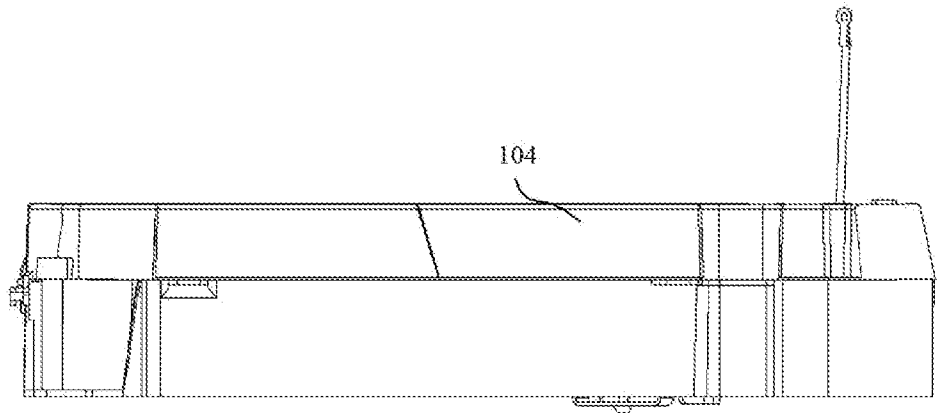


图 12

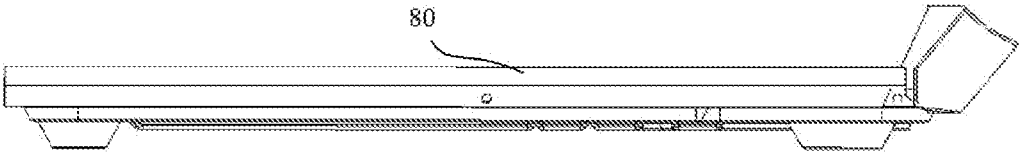


图 13

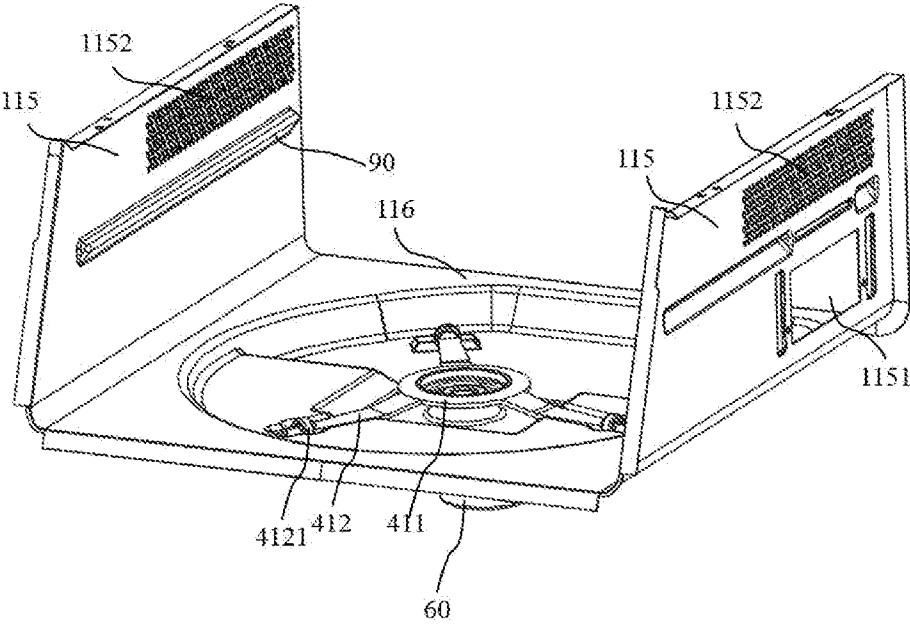


图 14

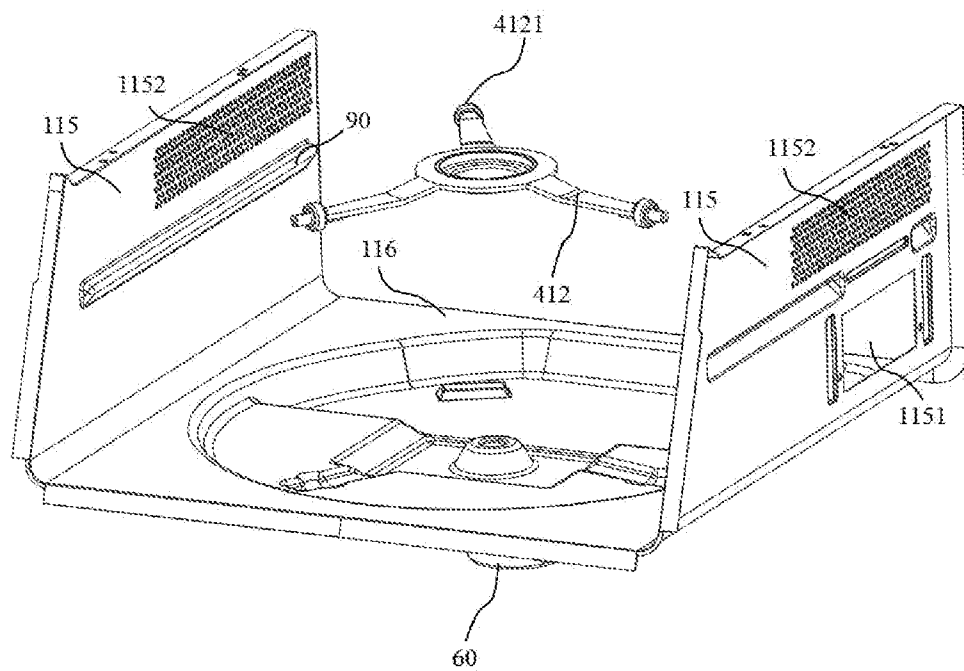


图 15

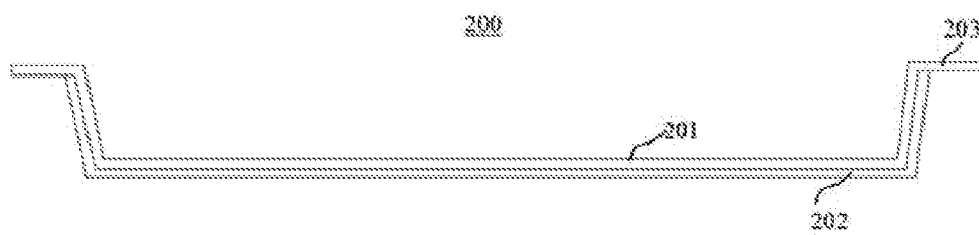


图 16

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2023/112627

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

F24C7/02(2006.01)i; F24C7/06(2006.01)i; F24C15/16(2006.01)i; H05B6/64(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: F24C, H05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT, WPABSC, VEN, CNKI: 微波炉, 微波, 底部, 底座, 底板, 下部, 热风, 加热, 转盘, 凹槽, 支架, 馈入口, 入口, 烤盘, 支承, 支持, 支撑, 搁板, 侧壁, 开口, cooking, base, microwave, rotary, disc, hot, air, holes, opening, supporting, baking, tray, bottom, feed, below, side, wall, heat

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 115711410 A (GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD. et al.) 24 February 2023 (2023-02-24) description, paragraphs [0004]-[0070], claims 1-10, and figures 1-4	1-10
PX	CN 116293835 A (GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD.) 23 June 2023 (2023-06-23) description, paragraphs [0006]-[0096], claims 1-10, and figures 1-12	11-20
X	JP 2017156053 A (HITACHI APPLIANCES INC.) 07 September 2017 (2017-09-07) description, paragraphs [0010]-[0076], and figures 1-12	11-18, 20
Y	JP 2017156053 A (HITACHI APPLIANCES INC.) 07 September 2017 (2017-09-07) description, paragraphs [0010]-[0076], and figures 1-12	1-10, 19
Y	CN 2807080 Y (LG ELECTRONICS (TIANJIN) APPLIANCES CO., LTD.) 16 August 2006 (2006-08-16) description, page 5, paragraph 2 to page 9, paragraph 1, and figures 3-6	1-10, 19
A	JP 2010261695 A (PANASONIC CORP.) 18 November 2010 (2010-11-18) entire document	1-20



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“D” document cited by the applicant in the international application

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 October 2023

Date of mailing of the international search report

01 November 2023

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District,
Beijing 100088

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2023/112627

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 205655361 U (JINAN JIATAI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.) 19 October 2016 (2016-10-19) entire document	1-20
A	CN 1143731 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) 26 February 1997 (1997-02-26) entire document	1-20
A	CN 103032907 A (TOSHIBA CORP. et al.) 10 April 2013 (2013-04-10) entire document	1-20
A	CN 101611732 A (TOSHIBA CORP. et al.) 30 December 2009 (2009-12-30) entire document	1-20
A	CN 1888576 A (LG ELECTRONICS (TIANJIN) APPLIANCES CO., LTD.) 03 January 2007 (2007-01-03) entire document	1-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2023/112627

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	115711410	A	24 February 2023	None			
CN	116293835	A	23 June 2023	None			
JP	2017156053	A	07 September 2017	JP	6488247	B2	20 March 2019
				TW	201732201	A	16 September 2017
				TWI	632330	B	11 August 2018
CN	2807080	Y	16 August 2006	None			
JP	2010261695	A	18 November 2010	WO	2010116717	A1	14 October 2010
				EP	2407722	A1	18 January 2012
				EP	2407722	A4	06 August 2014
CN	205655361	U	19 October 2016	None			
CN	1143731	A	26 February 1997	DE	69632801	D1	05 August 2004
				DE	69632801	T2	14 July 2005
				EP	0751698	A2	02 January 1997
				EP	0751698	A3	25 March 1998
				EP	0751698	B1	30 June 2004
				KR	970002515	U	24 January 1997
				KR	0119927	Y1	01 August 1998
				US	5674425	A	07 October 1997
CN	103032907	A	10 April 2013	JP	2013079744	A	02 May 2013
CN	101611732	A	30 December 2009	KR	20100002093	A	06 January 2010
				KR	101014043	B1	14 February 2011
				RU	2410606	C1	27 January 2011
				JP	2010007878	A	14 January 2010
				JP	5242250	B2	24 July 2013
CN	1888576	A	03 January 2007	None			

A. 主题的分类		
F24C7/02(2006.01)i; F24C7/06(2006.01)i; F24C15/16(2006.01)i; H05B6/64(2006.01)i		
按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类		
B. 检索领域		
检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)		
IPC: F24C, H05B		
包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献		
在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))		
CNABS, CNTXT, WPABSC, VEN, CNKI: 微波炉, 微波, 底部, 底座, 底板, 下部, 热风, 加热, 转盘, 凹槽, 支架, 馈入口, 入口, 烤盘, 支承, 支持, 支撑, 搁板, 侧壁, 开口, cooking, base, microwave, rotary, disc, hot, air, holes, opening, supporting, baking, tray, bottom, feed, below, side, wall, heat		
C. 相关文件		
类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
PX	CN 115711410 A (广东美的厨房电器制造有限公司 等) 2023年2月24日 (2023 - 02 - 24) 说明书第[0004]-[0070]段, 权利要求1-10, 附图1-4	1-10
PX	CN 116293835 A (广东美的厨房电器制造有限公司) 2023年6月23日 (2023 - 06 - 23) 说明书第[0006]-[0096]段, 权利要求1-10, 附图1-12	11-20
X	JP 2017156053 A (HITACHI APPLIANCES INC) 2017年9月7日 (2017 - 09 - 07) 说明书第[0010]-[0076]段, 附图1-12	11-18、20
Y	JP 2017156053 A (HITACHI APPLIANCES INC) 2017年9月7日 (2017 - 09 - 07) 说明书第[0010]-[0076]段, 附图1-12	1-10、19
Y	CN 2807080 Y (乐金电子(天津)电器有限公司) 2006年8月16日 (2006 - 08 - 16) 说明书第5页第2段至第9页第1段, 附图3-6	1-10、19
A	JP 2010261695 A (PANASONIC CORP) 2010年11月18日 (2010 - 11 - 18) 全文	1-20
A	CN 205655361 U (济南佳泰电器有限公司) 2016年10月19日 (2016 - 10 - 19) 全文	1-20
☒ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。		
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “D” 申请人在国际申请中引证的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件		
国际检索实际完成的日期		国际检索报告邮寄日期
2023年10月30日		2023年11月1日
ISA/CN的名称和邮寄地址		授权官员
中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088		梁月明
		电话号码 (+86) 010-62085033

C. 相关文件		
类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	CN 1143731 A (三星电子株式会社) 1997年2月26日 (1997 - 02 - 26) 全文	1-20
A	CN 103032907 A (株式会社东芝 等) 2013年4月10日 (2013 - 04 - 10) 全文	1-20
A	CN 101611732 A (株式会社东芝 等) 2009年12月30日 (2009 - 12 - 30) 全文	1-20
A	CN 1888576 A (乐金电子（天津）电器有限公司) 2007年1月3日 (2007 - 01 - 03) 全文	1-20

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2023/112627

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	115711410	A	2023年2月24日	无	
CN	116293835	A	2023年6月23日	无	
JP	2017156053	A	2017年9月7日	JP 6488247 B2	2019年3月20日
				TW 201732201 A	2017年9月16日
				TWI 632330 B	2018年8月11日
CN	2807080	Y	2006年8月16日	无	
JP	2010261695	A	2010年11月18日	WO 2010116717 A1	2010年10月14日
				EP 2407722 A1	2012年1月18日
				EP 2407722 A4	2014年8月6日
CN	205655361	U	2016年10月19日	无	
CN	1143731	A	1997年2月26日	DE 69632801 D1	2004年8月5日
				DE 69632801 T2	2005年7月14日
				EP 0751698 A2	1997年1月2日
				EP 0751698 A3	1998年3月25日
				EP 0751698 B1	2004年6月30日
				KR 970002515 U	1997年1月24日
				KR 0119927 Y1	1998年8月1日
				US 5674425 A	1997年10月7日
CN	103032907	A	2013年4月10日	JP 2013079744 A	2013年5月2日
CN	101611732	A	2009年12月30日	KR 20100002093 A	2010年1月6日
				KR 101014043 B1	2011年2月14日
				RU 2410606 C1	2011年1月27日
				JP 2010007878 A	2010年1月14日
				JP 5242250 B2	2013年7月24日
CN	1888576	A	2007年1月3日	无	